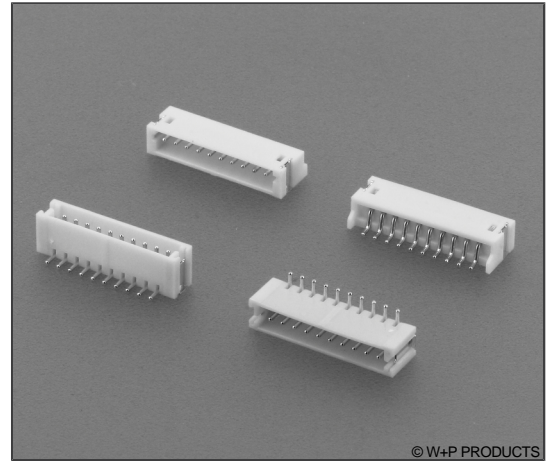


## SMT-Crimp-Rast-Stiftheilen RM 1,50mm, stehend/liegend, 1-reihig SMT Friction Lock Pin Headers, 1.50mm Pitch, Vertical/Horizontal, Single Row

### Technische Daten / Technical Data

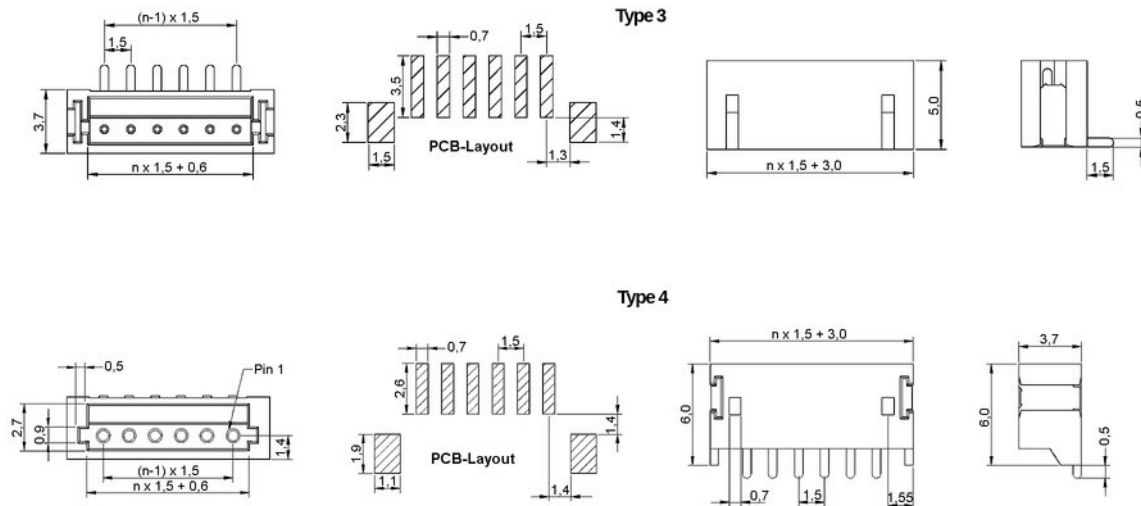
Isolierkörper	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Kontaktmaterial	Rundstift 0,50mm, Kupferlegierung
Contact Material	Round pin 0.50mm, Copper alloy
Aderquerschnitt	AWG 32 ~ 28
Applicable wire Gauge	AWG 32 ~ 28
Durchgangswiderstand	< 20mΩ
Contact Resistance	< 20mΩ
Isolationswiderstand	> 500MΩ
Insulation Resistance	> 500MΩ
Spannungsfestigkeit	500V <sub>AC</sub>
Test Voltage	500V <sub>AC</sub>
Nennspannung	100V <sub>AC</sub>
Voltage Rating	100V <sub>AC</sub>
Nennstrom	1A
Current Rating	1A
Temperaturbereich	-25°C ... +85°C
Temperature Range	-25°C ... +85°C
Verarbeitung	Reflow-Lötverfahren
Processing	Reflow soldering



© W+P PRODUCTS

Passende Buchsengehäuse Serien:  
Compatible Housing Series:

569



<b>Series</b>	<b>Contacts*</b>	<b>Type*</b>	<b>Plating</b>	<b>Packaging*</b>
<b>5690</b>	<b>06</b> 02-13	<b>3</b> 3 Stiftheile stehend Vertical pin header 4 Stiftheile liegend Horizontal pin header	<b>50</b> 50 Verzinkt Tin plated	<b>ST</b> ST TR (Option) FTR (Option)

\* Dies ist ein **Bestellbeispiel** - bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.  
\* This is an **order example** - please replace by your specifications.

### Lieferformen / Packaging Options:

- ST** In Stangen ohne Pick&Place-Pads / In tubes w/o Pick&Place Pads
- TR (Option)** Tape & Reel ohne P&P-Pads / Tape & Reel w/o P&P Pads
- FTR (Option)** Tape & Reel mit P&P-Film-Pads / Tape & Reel with P&P Film Pads

# Informationen zum Reflow-Lötverfahren

## Reflow Soldering Information

### Reflow-Lötempfehlung

#### Reflow Soldering Recommendation

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum $T_{Smin}$	150°C
Temperatur Maximum $T_{Smax}$	200°C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Temperatur Lötbereich $T_L$	217°C
Verweildauer oberhalb $T_L$	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Höchsttemperatur $T_P$	260°C ±5
Dauer Höchsttemperatur	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Dauer 25°C - Höchsttemperatur $T_P$	Max. 8 min

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature $T_{Smin}$	150°C
Maximum Temperatur $T_{Smax}$	200°C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Soldering Range Temperature $T_L$	217°C
Duration above $T_L$	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Peak Temperature $T_P$	260°C ±5
Duration Peak Temperature	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Duration 25°C - Peak Temp. $T_P$	Max. 8min

